РАРАНСЬКИЙ М.Д., ФОДЧУК І.М., НОВІКОВ С.М., КОРОВЯНКО О.Ж., БОБРОВНИК С.В., МАРМУС П.Є.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ МІКРОДЕФЕКТІВ НА РЕНТГЕНІВСЬКИХ СЕКЦІЙНИХ ТОПОГРАМАХ

На основі чисельного рішення рівнянь Такагі досліджено вплив різних факторів на формування зображень мікродефектів, розподілених як упорядковано, так і хаотично по об'єму кристалу на секційних і плоскохвильових топограмах.

Визначення типу і характеру розподілу мікродефектів по об'єму кристалу має важливе практичне значення. Крім класичних методів селективного травлення для виявлення мікродефектів в Si, в останні роки інтенсивно використовуються інтегральні дифрактометричні рентгенотопографічні Так i метоли. як мікродефекти мають відносно мале i швилкоспалне поле деформацій, то однокристальні топографічні методи виявляють мікродефекти у товстих кристалах тільки після спеціального декорування домішками. Тому на даний час досить широко використовуються методи моделювання дифракційних процесів в реальних кристалах, що містять дефекти кристалічної будови. Кількісні і якісні розподіли деформаційних полів в областях локалізації дефектів на рентгенівських топограмах визначаються шляхом співставлення чисельно промодельованих i експериментально отриманих зображень [1-3].

В даній роботі на основі чисельного розрахунку основних рівнянь динамічного розсіяння рентгенівських променів реальними кристалами (рівнянь Такагі) проведені моделювання секційних топограм кристалів кремнію, що містить певним чином розподілені мікродефекти. Розглянуті випадки: декілька - п'ять (n=6.2·105 см-3) мікродефектів, розміщених гіпотетичних в різних площинах розсіяння через 72 мкм по товщині (рис.1а,в,д), і двісті хаотично мікродефектів $(n=2.5\cdot10^7)$ кристалу см-3) розподілених по (рис.1б,г,е). Такий вибір кількості і розміщення мікродефектів мав на меті створити найбільш сприятливі умови для дослідження механізмів формування топографічних зображень і дифрактометричних кривих, з метою найточнішого визначення інтегральних характеристик реальних кристалів.

Товщина кристалу 300 мкм. Орієнтація вхідної поверхні (001), відбивання (220) і (440). Включення моделюються сферичносиметричним пружним полем із зміщенням у вигляді:

$$\mathbf{r} \mathbf{r} \mathbf{r} = \frac{C}{r^3} \mathbf{r}$$

де С - параметр деформації, або параметр "потужності" мікродефекту, який пропорційний об'єму когерентного сферичного включення.

Для більш повного уявлення про дифракційні процеси розсіяння в кристалі розраховувались також просторові розподіли інтенсивності $I_h(x)$, $I_h(y)$ по основі палатки Бормана. Шляхом інтегрування всієї топограми по координатах x, y отримані оцінки зміни відбиваючої здатності кристалу R без та з мікродефектами.

На рис.1 досліджено вплив величини параметра деформації С на роздільну здатність мікродефектів на розрахункових секційних топограмах. Геометрія розміщення мікродефектів в кристалі і змодельовані зображення дали змогу визначити критерій для розділення зображень двох мікродефектів, розміщених в напрямку осі Оу, нормальної до площини розсіяння. Відзначимо, що збільшення "потужності" мікродефектів в тонкому кристалі з $C=4\cdot10^{-17}$ до $C=16\cdot10^{-16}$ см⁻³ приводить до збільшення відбиваючої здатності тонкого кристалу майже на 25%, в той же час в кристалі проміжної товщини до її подавлення на 5%.

Як свідчать просторові розподіли інтенсивності $I_h(y)$ мінімальне розділення Δy_{kp} , яке необхідне для того, щоб два преципітати були ще розділені, визначається як функція деформаційного параметра С. Критична відстань Δy_{kp} , при якій преципітати були ще розділені, зменшується із ростом параметра С по логарифмічному закону, тобто Δy_{kp} -lnC. Це добре узгоджується з результатами експериментальних робіт [3,4].

Досліджено також вплив поверхневої релаксації напруг на механізми формування дифракційних зображень мікродефектів. В цілому, вплив релаксації змінює, тобто уширює розеточні зображення як в площині розсіяння, так і перпендикулярно їй. Найбільш чітко це відображаються для тих мікродефектів, які найближчі до вихідної поверхні кристалу. Для ізольованої нерелаксуючої частинки така зміна в зображенні не залежить від положення мікродефекту всередині кристалу і є, таким чином, особливо надійним методом визначення С. Проведені нами дослідження показують, що товщина кристалу, на якій вплив поверхневої релаксації стає непомітним, зростає із збільшенням "потужності" мікродефекту і задовільно апроксимується логарифмічною залежністю параметра С, тобто пропорційно lnC.



Рис.1. Секційні топограми Si з мікродефектами: a), б), д), е) C=4 10⁻¹⁷см⁻³; в), г) C=16 10⁻¹⁶. a)-г) (440), МоК_α, μt≈0.44. д), е) (220), CuK_α, μt≈4.4.

Таким чином, вплив поверхневої релаксації на зображення преципітатів на рентгенівських секційних топограмах істотний для тих мікродефектів, які знаходяться поблизу вхідної або вихідної поверхонь кристалу і проявляється в збільшенні їх розмірів, а також в зміні співвідношень динамічного і проміжного зображень. Релаксація стає мало помітною на значних товщинах розміщення мікродефектів і змінюється за логарифмічним законом від параметра деформації С.

На рис.2. представлені результати дослідження взаємодії зображень однакової "потужності" мікродефектів, розміщених таким чином в площині розсіяння, що "новоутворені" хвильові поля на мікродефектах співпадали за напрямком розсіяння. Як слідує з

аналізу розподілу інтенсивності в площинах розсіяння у випадку окремих мікродефектів (рис.2а.б), і випалку їх суперпозиції результуюча картина взаємодії не є простим накладанням їх зображень (рис.2г). Взаємодія динамічної, проміжної і кінематичної складових зображень має в площині розсіяння екстинкційно-фазову природу. Про це свідчить те, що в області перекриття хвильових полів утворених мікродефектами, виникають екстинкційні контури із зміненими періодами, а також деякий перерозподіл інтенсивності між ними. В кількісному вираженні це добре видно із просторових палатки розподілах інтенсивності по основі Бормана (рис.2л). Очевидно, що така не адитивна взаємодія динамічних і кінематичних складових зображень може приводити до певних неточностей при визначенні розмірів і концентрації мікродефектів із дифрактометричних



Рис.2. Формування зображень двох мікродефектів (C=16 10⁻¹⁶см⁻³, CuK_α, µt≈4.4) a), б) на різних висотах в площині розсіяння; в) суперпозиція двох МД; г) просторовий розподіл: А- без МД; В, С, D -випадки а), б), в) - відповідно.

даних. Тому, напевно, потрібно враховувати таку взаємодію. Слід також зауважити, що чим більші за розмірами або "потужністю" мікродефекти, тим більше коефіцієнт такої невідповідності.

Таким чином, проведений експеримент на основі чисельного розв'язку рівнянь Такагі дав змогу вплив деяких внутрішніх факторів на механізми формування зображень мікродефектів на рентгенівських секційних топограмах. Це створює базу для значного підвищення ефективності і експресності як топографічних, так і дифрактометричних методів у визначенні типу, розмірів, концентрації і однорідності розподілу мікродефектів в кристалах.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- 1. Takagi S. A dynamical theory of diffraction for a distorted crystals // Phys.Stat.Sol.-1969.-26, №5.-P.1239-1253.
- Dislocation Contrast in the Case of Anomalous X- ray Transmission / Suvorov E.V., Indenbom V.L. etc. // Phys.Stat.Sol.(a).-1980.-60, N1.-P.27-35.
- 3. B.K. Tanner, Analysis of Microelectronic Materials and Devices.-Wiley: Eds. H. Werner and M. Grasserbauer, 1991.
- 4. Novel Analysis System of Imaging-Plate Plane-Wave X-ray Topography for Characterizing Lattice Distirtions in Silicon / Kudo Y., Shigeru K., Liu Y.K., Kawado S. and Ishikawa T.// Jap. J. Appl. Phys.-1994.- **33**,N68.-P.823-825.

SUMMARY

RARANSKY M.D., FODCHUK I.M., NOVIKOV S.M., KOROVYANKO O.J.,BOBROVNIK S.V., MARMUS P.E. FORMATION FEATURES OF THE MICRODEFECT IMAGES ON X-RAY SECTION TOPOGRAPHS

On the basis of the numerical solution of Takagi equations influence of the various factors on images formation of microdefects, both regulary and chaotic distributed on volume of a crystal on section and plane wave topographs is investigated